

2005年12月6日

報道各位

株式会社日鉱マテリアルズ

高純度銅スパッタリングターゲットの製造設備の能力増強について

1. 新日鉱グループの中核事業会社である株式会社日鉱マテリアルズ（本社：東京都港区虎ノ門二丁目、社長：山梨功雄、以下「当社」）は、来年12月を目途に、半導体の製造に用いられる高純度銅^(注1)スパッタリングターゲット^(注2)の製造設備の能力を増強することとしましたので、お知らせします。
2. 半導体は、パーソナルコンピュータのメモリやMPU（Micro Processing Unit：超小型処理装置）として使用されるのをはじめ、携帯電話やデジタル家電など、高度な制御を行う電子機器には欠かせないデバイスとして、需要の拡大が続いています。また、半導体の一層の小型化、高速化、省電力化を図るため、材料に対する要求特性も年々厳しくなっています。
3. 当社は、1985年4月より各種スパッタリングターゲットを生産し、顧客である半導体メーカー各社から多くの表彰を受賞するなど、高い評価を受けています。とりわけ、MPUなどのロジックの配線材として欠かせない高純度銅スパッタリングターゲットについては、原料となる高純度銅からの一貫生産により高い品質を実現したことで、事実上の業界標準としての地位を確立しています。
4. 能力増強後の高純度銅の製造設備の概要は以下のとおりです。
 - (1) 設置箇所：当社 磯原工場（茨城県北茨城市）
 - (2) 生産能力：約40トン/月（増強前の能力：約30トン/月）
 - (3) 投資金額：約10億円
 - (4) 工事期間：2005年11月～2006年11月
 - (5) 稼働予定：2006年12月
5. 当社は、半導体用スパッタリングターゲット事業を成長戦略の柱の一つと位置付けています。引き続き本製品を効率的かつ安定的に供給し、今後とも顧客に密着した製品開発に努め、マーケットニーズに応じてまいります。

以上

株式会社日鉱マテリアルズ
総務部【大島、田代】

TEL：03(5573)6554 FAX：03(5573)6777
メールアドレス：ask@nikko-materials.co.jp

注1 6N (six-nine:99.9999%)にまで純度を高めた銅のこと。これに対し、電線などに使用される一般的な銅の純度は4N (four-nine:99.99%)。

注2 半導体、液晶パネルなどのFPD、ハードディスクや光ディスクのような記録メディアなどに使われる薄膜形成材料。

参考 半導体300mmウェハー用高純度銅スパッタリングターゲットの例 (写真)



当社は、12月7日(水)～9日(金)に幕張メッセで開催される SEMICON Japan 2005 において、高純度銅スパッタリングターゲットをはじめとする最先端材料を展示しております(当社ブース# 3A-1006)。

SEMICON Japan 2005 の詳細につきましては、www.semi.org をご覧下さい。